

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

北京赛微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	天风证券：程如莹、李佳茵 诺安基金：陈衍鹏、黄友文、李迪、童宇、王创练、陆伟成
时间	2022年2月10日下午15:00-16:00
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：张阿斌 副总经理、证券事务代表：刘波
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：上市公司介绍了赛微电子的发展历程以及最新动态，近年来，面向万物互联与人工智能时代，赛微电子已形成以半导体为核心的业务格局，MEMS、GaN成为分处不同发展阶段、聚焦发展的战略性业务。与此同时，公司围绕相关产业开展投资布局，服务主业。基于业界顶级专家工程师团队、所掌握的成熟工艺以及持续扩张的MEMS领域先进的8英寸产能，赛微电子积极把握市场需求，为全球客户提供高标准的MEMS芯片工艺开发及晶圆制造服务；同时基于业界顶级技术团队及优异的产品性能，积极快速地布局GaN产业链。赛微电子执行长期发展战略，致力于成为一家立足本土、国际化发展的知名半导体科技企业集团。</p> <p>第二部分：上市公司解答提问，主要提问及解答如下：</p>

1、请问公司的 MEMS 及 GaN 业务在产业链中如何定位？公司这两项业务在 2020 年及 2021 年中的结构占比情况如何？2021 年上半年 MEMS 的收入是否全部来自瑞典产线？公司 GaN 业务在未来的成长情况如何？

答：从产业链角度而言，对于 MEMS 业务，公司目前处于“设计-制造-封测”中的制造环节，属于纯代工厂商，类似于台积电、中芯国际的商业模式；同时公司正在陆续布局下游封测环节，公司不涉足 MEMS 设计，但不排除通过产业基金等方式对一些设计公司进行小比例投资，主要目的还是为了公司核心代工业务的发展。对于 GaN 业务，公司起初只是布局了属于轻资产性质的材料和设计环节，后来由于各种外部原因而被迫加强布局了制造环节，当然目前制造环节这块在上市公司体外，属于公司参股子公司。

公司目前的主营业务为 MEMS 和 GaN, 随着业务转型的完成以及业务自身的发展, 该两项业务在 2020 及 2021 年在主营业务中的合计占比逐步提高, 2020 年接近 90%, 2021 年超过了 90%, 截至目前的占比已超过 95%。2021 年上半年, 由于北京 FAB3 尚未贡献收入, 公司 MEMS 业务收入均来自于瑞典产线 FAB1 和 FAB2。

第三代半导体材料及芯片具有高功率、高频、耐高温高压及抗辐射等特点, 拥有广阔的替代及新生应用前景, 行业整体属于初创期, 同时基于 GaN 技术的芯片及材料应用案例已不断涌现, 市场规模迅速增长。

公司 GaN 业务已经历多年积累, 目前虽然增速较高, 但由于核心产能问题尚未解决, 绝对金额数值仍较低。在 GaN 外延片方面, 公司已建成的 6-8 英寸 GaN 外延材料制造项目(一期)的产能为 1 万片/年, 目前已签订千万级销售合同并根据商业条款安排生产及交付, 公司既可以提供标准化产品, 也可以根据境内外不同类型客户的需求提供定制化产品, 不同规格产品

的单价差异较大；在 GaN 器件设计方面，产能主要受到供应方制造商产能的限制，目前在技术、应用及需求方面是没问题的，关键在产能供应端受限，在这方面公司也已对外签订了批量流片合同，努力缓解产能瓶颈问题。另一方面，公司间接参股的青州聚能国际半导体制造有限公司正在推进建设 GaN 产线，希望能够尽快提供自主可控、全本土化的 GaN 制造能力。整体而言，公司还是非常看好 GaN 业务的发展前景。

2、请问公司收购瑞典 Sillex 之后是如何进行管理的？瑞典 Sillex 与公司境内产线之间的技术交流与合作又是什么状态？瑞典 ISP 的决定对上述技术合作产生了哪些影响？

答：公司在 2016 年完成对瑞典 Sillex 的收购后即将该公司及其欧洲和北美子公司纳入集团统一财务管理、形成有效控制，并根据集团信息披露或其他事项的需要定期及不定期取得瑞典子公司的所有财务数据及报表，与集团对其他境内外子公司的管理要求一致（当然其中境外子公司涉及 IFRS 与中国会计准则的转换）；收购完成后，公司延续聘请瑞典普华（PWC）对瑞典 Sillex 进行年度审计。公司目前由全资子公司赛莱克斯国际统筹集团 MEMS 业务资源，下辖瑞典产线与北京产线以及位于瑞典、美国、香港的其他子公司；公司在赛莱克斯国际层面统一负责管理运营 MEMS 业务，由其在集团层面授权范围内制订具体经营计划，包括市场开拓、产能建设、订单分配、工艺开发、生产安排、材料采购、人力资源等。在集团层面，公司一直重视推动旗下境内外子公司在发展愿景、管理体系、激励机制、企业文化等方面的融合互补。欧洲市场经济及相关法律体系发达完备，信用环境良好，近年来相关子公司的管理保持畅通有序。

从收购完成到瑞典 ISP 审查事项发生前，公司瑞典工厂与北京工厂开展了全面的技术合作，双方市场共享、定期互访、

互相派驻工程师进行培训交流，尤其瑞典对北京 FAB3 的建设及设备采购等事项提供了许多支持。

受瑞典 ISP 审查及否决决定的影响，瑞典工厂与北京工厂之间的技术合作处于中止状态，北京 FAB3 需要继续自主探索相关生产诀窍，实现工艺成熟可能需要耗费更多的时间与成本，其代工 MEMS 晶圆品类的拓展需继续依赖于自身而无法通过瑞典 Silex 的技术支持实现加速；对于瑞典 Silex 原有的中国大陆客户，其向北京 FAB3 转产的计划安排也受到一定影响，往往需要在 FAB3 重新经历工艺开发的过程。

到目前为止，公司北京 FAB3 已实现量产出货并持续进行产能爬坡，部分量产产品的良率已超过瑞典产线。在瑞典 ISP 不改变现有立场的情况下，瑞典工厂的工艺技术无法直接输送给公司境内产线，该等本土产线将基于国际化人才团队、市场需求及生产实践不断积累自主工艺技术，并积极进行自主创新。若未来国际政经环境改善，公司将积极促进境内外产线之间的技术交流与合作。

3、请问当前国际局势复杂，中美关系紧张，近年来瑞典 Silex 是否因中美关系变化而发生客户流失的情况？

答：从中美贸易争端到目前双方乃至多方的复杂角力格局，时间已过去数年。对于瑞典 Silex 自身的业务而言，除与极少数客户之间的合作受到有限的影响之外，整体上并未受到中美关系明显的冲击，过去数年来自北美、欧洲、亚洲的客户、订单及收入均呈增长态势。当然，公司将继续密切关注国际局势及海外经营环境的变化，并根据相关事态发展情况及时采取有效的应对措施。

4、请问公司收购德国产线的进度如何？

答：本次收购事项尚需欧盟和德国政府相关部门的审批，包括

但不限于从德国联邦经济事务与气候行动部(Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action)获得 FDI(Foreign Direct Investment, 外商直接投资)相关批准证书, 能否获得批准以及获得批准的时间存在不确定性, 但双方均会尽快推进本次交易, 申请审批的相关工作目前均在正常推进中。若相关前置审批事项进展顺利, 交易双方希望能够在今年 6 月底前尽快完成交割。

5、请问公司瑞典产线 FAB1 和 FAB2 的产能规模如何? 2021 年公司瑞典及北京产线的利用率情况如何? 最近一个月的情况如何?

答: 自并购完成后公司便积极支持瑞典产线升级及持续扩产。瑞典产线在 2017-2020 年进行了超过 3 亿元人民币的资本投入, 2020 年 9 月, 瑞典原有 6 英寸产线(FAB1)升级切换成 8 英寸产线, 原有 8 英寸产线(FAB2)亦已完成扩产, 合计 MEMS 晶圆产能提升至 7,000 片/月的水平, 产能在 2019 年末的基础上继续提升了 30%, 且截至目前因重点客户需求仍在持续进行资本投入。

由于瑞典产线近年来进行了大规模的升级扩产, 在此状态下的产线潜力尚未完全发挥, 就目前情况来看, 基于瑞典产线本身的工艺中心定位和中试量产共同进行的混线特点, 80%左右的产能利用率已属于业内领先水平, 随着大规模升级扩产工作的完成, 生产逐步稳定, 瑞典产线的产能利用率在未来仍有一定的提升空间。目前, 公司北京 FAB3 二期产能(即合计 2 万片/月产能)的建设已经在进行中; 北京 FAB3 属于从零开始, 随着工艺制造水平的逐渐成熟, 订单及客户需求的逐步增长, 北京 FAB3 自 2022 年起的产能爬坡进度有可能加快。最近一个月的情况在当前时点尚不方便透露, 但可以明确的是瑞典及北京产线的状况都是在逐步改善的。

6、请问公司是否有北京产线 FAB3 预计的满产时间？目前的进度情况如何？

答：公司北京 MEMS 产线的建设总产能为 3 万片/月，一期产能已于 2021 年 6 月实现正式生产，目前已实现量产出货并持续进行产能爬坡；就产能规划而言，计划在 2022 年尽快实现一期 100%的产能，即产能达到月产 1 万片晶圆的水平；在 2024/2025 年尽快实现 3 万片/月总产能的达产满产。目前，公司北京 FAB3 二期产能(即合计 2 万片/月产能)的建设已经在进行中；北京 FAB3 属于从零开始，随着工艺制造水平的逐渐成熟，订单及客户需求的逐步增长，北京 FAB3 自 2022 年起的产能爬坡进度有可能加快。

7、请问瑞典产线的产能是否还会继续提升？瑞典产线的产能利用率能否继续提升？瑞典产线满产的情况下能够实现多少营业收入？

答：因市场需求驱动，瑞典产线的产能扩充活动仍在持续进行，但受物理空间所限，其未来继续提升的空间有限，将主要依赖于现有设备的更新换代。且基于公司布局境外产线的努力，瑞典 Silex 并不需要仅局限于在本地扩充产能，但产能利用率及良率均存在继续提升的空间。瑞典产线的营业收入规模受客户及产品结构所影响，其静态满产情况下的营收增长潜力可以将公司 2021 年股权激励所设置的考核目标作为参考。

8、请问对于不同的客户，公司向其销售的 8 英寸晶圆的价格差异大吗？

答：晶圆价格是根据具体的合作背景，基于特定用户、特定订单量、特定产品、行业惯例、供需关系等综合要素情况下协商而成，因此不同行业、同行业不同客户、同客户不同产品的晶

圆价格均存在较大差异。

9、请问从商业模式上，瑞典产线完成工艺开发后的客户，其量产阶段的订单能够导入到北京产线吗？

答：在业务层面，公司旗下不同产线可以开展正常商业合作，瑞典产线的工艺开发客户也可以将其晶圆制造阶段的订单导入北京产线执行。只是受瑞典 ISP 审查及否决决定的影响，不排除相关客户需要在 FAB3 重新经历工艺开发的过程。

在技术层面，在瑞典 ISP 不改变现有立场的情况下，瑞典工厂的工艺技术无法直接输送给北京 FAB3 产线，公司也因此调整了原有的“工艺-量产”分工路线，改为境内外芯片工厂体系都同时具备工艺开发与晶圆制造能力，均有能力独立导入客户并实现量产。

若未来国际政经环境改善，公司将继续积极促进境内外产线之间的技术交流与合作。

10、请问相较其他竞争对手，贵公司在 MEMS 业务方面的核心竞争力主要体现在哪里？公司在晶圆代工方面有哪些优劣势？

答：公司在 MEMS 芯片工艺开发及晶圆制造方面已经深耕二十年，存在着显著的竞争优势，主要如下：（1）突出的全球市场竞争地位；（2）先进的制造及工艺技术，掌握了多项在业内极具竞争力的工艺技术和工艺模块；（3）标准化、结构化的工艺模块；（4）覆盖广泛、积累丰富的开发及代工经验；

（5）产业长期沉淀、优秀且稳定的人才团队；（6）丰富的知识产权；（7）中立的纯晶圆厂模式；（8）前瞻布局、陆续实现的规模产能与供应能力。国内现在也有一些做得很好的 MEMS 产线，但从工艺及芯片类别的覆盖广度、工艺开发及量产经验来说，公司还是具备突出的竞争优势。当然公司目前的劣势也

	较为明显，即整体产能及营收规模较小，短期内尚缺乏规模效应，工艺优势尚未得到完全发挥和体现，境内产线团队仍需要通过量产实践加以磨练。
附件清单(如有)	无
日期	2022年2月10日